

Informations de base	
<b>2013/2905(DEA)</b>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
DEA - Procédure d'acte délégué	
Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C	
Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>	
<b>Subject</b>	
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Informations techniques	
<b>Référence de la procédure</b>	2013/2905(DEA)
<b>Type de procédure</b>	DEA - Procédure d'acte délégué
<b>Sous-type de procédure</b>	Examen d'un acte délégué
<b>Modifications et abrogations</b>	Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>
<b>État de la procédure</b>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
<b>Dossier de la commission</b>	ENVI/7/14364